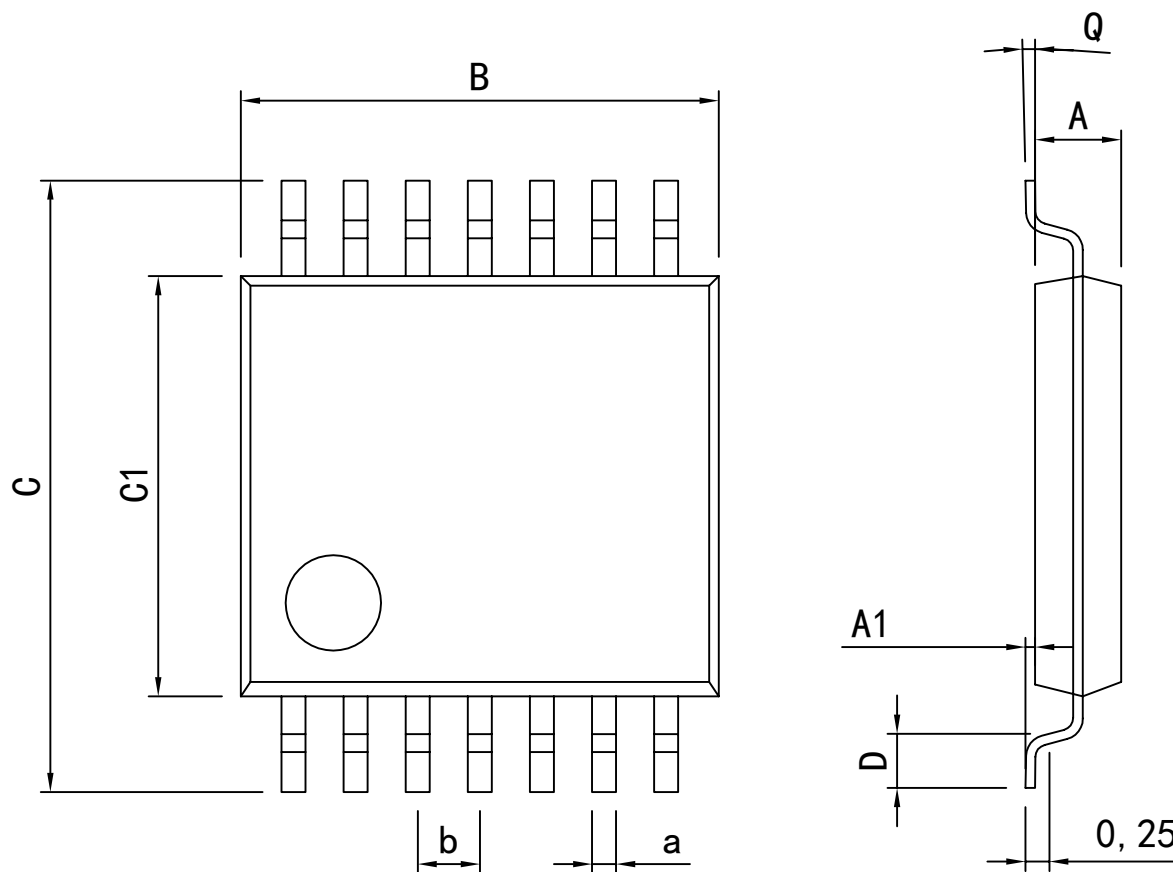




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



| | |
|----|-----|
| 制图 | 赖谊成 |
| 审阅 | 罗云龙 |
| 核准 | 林钟涛 |

TSSOP-14

文件名称:
HG-TSSOP14

文件编号:
HGWXT-230008

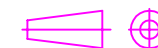
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-27

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

| DIM. | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| MIN | 0.85 | 0.05 | 4.90 | 6.20 | 4.30 | 0.40 | 0° | 0.20 | 0.65 | | | |
| MAX | 0.95 | 0.20 | 5.10 | 6.60 | 4.50 | 0.80 | 8° | 0.25 | BSC | | | |